

AI世代之電子連接 產業論壇

2026/09/01 (二) 台北富邦國際會議中心

★尖端電子連接技術★

★AI技術應用★

★永續與雙軸轉型★

主辦：TECA 台灣電子連接產業協會

會議日期：2026/09/01(二)

會議地點：台北富邦國際會議中心(台北市松山區敦化南路一段 108 號)

參加人數：預估參加人數為 300 人

會議費用：NT\$4,200 元(第 2 人 NT\$2,000 元/位)

★TECA 會員一級 免費 4 位、二級 免費 3 位、三級 免費 2 位

★AI 應用聯盟會員免費 2 名 / 公司

▶ 活動報名：<https://www.e-teca.org.tw/friendship-page3386>

▶ 活動聯絡：03-5910002 林小姐 Jessica、余小姐 Mancy、03-5910003 朱資深經理



【主會場】

時間	上午主會場議題	單位
9:00	會議報到	-
9:25	大會開幕	TECA 陳伯榕理事長
9:30	2026 電子連接產業發展與探討	TECA 彭永權秘書長
10:00	全球佈局與供應鏈轉型	貿聯集團
10:30	茶歇	-
11:00	台灣 AI 產業發展趨勢與未來	工研院 連俊宏副組長
11:30	AI 伺服器市場全貌及相關供應鏈	工研院 石立康研究經理
12:00	午餐 Lunch	-

下午：第一分會場(A) 尖端電子連接技術 (贊助發表)

時間	議題	單位
13:00 16:00	AI 時代高速纜線測試自動化之創新突破	是德科技*
	224Gbps 及 CPO 高速傳輸解決方案	是德科技*
	量子電腦的挑戰與未來衝擊	安立知
	5G 無線通訊的未來	鑑微
	矽光子技術發展與市場趨勢	匯佳新
	精準量測 × AI 檢測：迎接高階連接器品質挑戰	《待邀》

下午：第二分會場(B) AI 技術應用 (贊助發表)

時間	議題	單位
13:00 16:00	AI 如何重塑高速連接器的 EDA 設計流程	瑞士商優力
	AI 資料中心連接器歐規標準簡介	德國萊因*
	AI 時代的高頻矩陣連接器檢測的挑戰	虎門
	用 AI 打造連接器產業: SIMULIA 機器學習解決方案	實威
	從模擬到 AI：提升連接器研發效能	嘉航*
	未來 AI 系統和連接器的發展趨勢	《待邀》

下午：第三分會場(C) 永續與雙軸轉型 (贊助發表)

時間	議題	單位
13:00 16:00	ESG 永續：以數據驅動的供應鏈韌性	雲力橘子
	邁向變革的力量：數位與永續的融合實踐	《待邀》
	AI 賦能永續轉型：解鎖智慧製造新潛力	《待邀》
	數位永續與永續數位：雙軸交織的營運策略	《待邀》
	數位創新打造綠色競爭力	《待邀》

~ 精彩講座 即刻報名 ~

歡迎 發表 + 擺攤			
編號	等級	內容	價格(新台幣・未稅)
1	鑽石級	擺攤 2 + 發表-上午主會場 1 場、下午分會場 2 場	NT\$148,000-
2	白金級 PLUS	擺攤 2 + 發表 2	NT\$88,000-
3	白金級	擺攤 1 + 發表 1	NT\$50,000-
4	黃金級	擺攤或發表擇一	NT\$30,000-

★贊助發表：朱靜慧

Tel：+886-3-5910003 | Email：shiner@teca.itri.org.tw